

## KLA、先端半導体パッケージングの新時代に向けた 各種 IC サブストレート・ポートフォリオを発表

- 新しいポートフォリオは、パネルベース配線接続のイノベーションにより、チップの性能を促進
- ダイレクトイメージング装置として、機能拡張した *Corus™* と今回新たに発表する *Serena™* の導入により、メインストリームならびに最先端 IC サブストレートのリソグラフィ要件をサポート
- 新製品の *Lumina™* 検査および計測システムは、IC サブストレート（ガラスコアを含む）およびパネルベースのインターポーザーメーカー向けに、高い品質と歩留まりで先進的な製品を効率的に実現する高度なものづくりを提供

カリフォルニア州ミルピタス、2024年10月15日-本日、[KLA Corporation](#) (NASDAQ: KLAC) は、IC サブストレート(ICS)製造向けの業界で最も幅広いプロセス制御とプロセスを可能にする新製品を発表しました。フロントエンド半導体、パッケージング、IC サブストレートにおける KLA の専門知識を組み合わせることで、お客様は高性能アプリケーションをターゲットにしたチップのパッケージング相互接続密度の画期的な向上を実現することができます。



KLAは、ICサブストレート製造向けの業界で最も幅広いプロセス制御とプロセスを可能にする新製品を提供します。ICサブストレートやインターポージャーなどのパネルベースの中間パッケージングレベルでイノベーションが加速する中、お客様は高性能アプリケーションをターゲットにしたチップのパッケージング相互接続密度の課題を解決するため、新たなソリューションを必要としています。

最先端パッケージングでは、ヘテロジニアスインテグレーションメソッドを引き続き採用し、複数の半導体コンポーネントを統合することで、性能、電力、コストのメリットを実現しています。進化する相互接続要件を満たすために、ICサブストレートやインターポージャーなどのパネルベースの中間パッケージングレベルでは、イノベーションが加速しています。これらの技術は、チップとプリント基板（PCB）を効率的に接続するために使用されます。パッケージ寸法が拡大し、機能サイズが縮小され、ガラスなどの新規材料が導入される昨今、メーカーはKLAのソリューションを活用し、歩留まりの向上、納品サイクルの加速、全体的な生産性の向上ができます。

KLAのダイレクトイメージング（DI）、欠陥検査、シェイピング、計測、化学プロセスコントロール等の包括的な製品ラインナップと、インテリジェントソフトウェアソリューションは、最先端のパッケージング製造ワークフローを最適化します。

KLAは、さまざまな顧客のリソグラフィ要件に対応可能なダイレクトイメージングの製品ラインナップを揃えています。Corus™ダイレクトイメージング装置は、製造現場で実際に採用されており、高い柔軟性と効率的な露光技術を提供できることを証明しています。ICサブストレートや次世代HDIなどのアプリケーションに対する進化し続けるニーズを満たすために独自開発した次世代光学系とレーザーにより、あらゆる基板表面の凹凸に対し、高速かつ高品質に最適なダイナミックイメージングを提供します。

最先端ICサブストレートアプリケーションでは、ダイレクトイメージングはリソグラフィ用のステッパーを超えた新しいカテゴリとなりえます。KLAの新しいダイレクトイメージング装置Serena™は、柔軟かつ効率的なデジタルソリューションにより精度ならびに歩留まりを向上させ、大型で高多層の有機基板でも、高品質かつ高精細なパターニングを実現します。



KLA の新しい検査および計測装置 [Lumina™](#) は、最先端の IC サブストレート（ガラスコアを含む）およびパネルベースのインターポージャー向けに、高感度検出とスキャン計測を実現し、所有コストを最適化します。AI ベースのレビューと分類を組み合わせたモニタリングにより、オペレーターの入力がなくとも実用的な欠陥パレートチャートを作成するとともに、KLA のシェイピングソリューションとのシームレスな統合を実現します。

すでに実証されている KLA プロセス制御ソリューションである Orbotech Ultra PerFix™、EcoNet™、Zeta™-6xx、ICOS™ T890、Quali-Fill® Libra®、QualiLab® Elite などの製品ラインナップにより、新システムはその強みをさらに発揮します。

歩留まり管理において、長年にわたり業界をリードしてきた KLA の Frontline® ソフトウェアは、生産・製造設計支援システム、データ編集システム（CAM）、生産データ分析システムなど幅広いソリューションを提供しており、IC 基板製造全体のインテリジェンスを一元化します。

KLA 執行副社長兼最高戦略責任者の Oreste Donzella は、「本日の新製品発表は、KLA が半導体エコシステムイノベーションにおけるリーダーであることを明確に示しています。IC サブストレートやその他のパネルレベルのパッケージング技術は明日の高性能チップ内の接続性を前進させるのに不可欠であり、KLA は複雑な生産課題を解決するために、お客様と協力して取り組んでいます。」と述べています。

KLA の IC サブストレート向けの包括的な製品ラインナップについては、台湾で開催される [TPCA Show](#) にてご紹介します。

## **KLA について**

KLA Corporation（「KLA」）は、先端電子産業向け装置の開発やサービスの向上を通して、エレクトロニクス業界全体のイノベーションを牽引しています。半導体産業向けプロセス制御装置（検査・計測）、ウェハーやレチクル、集積回路、パッケージ、プリント基板製造を実現するソリューションを提供しています。世界中の主要顧客との緊密な連携により、物理学の専門チーム、エンジニア、データサイエンティスト、問題解決の専門チームが、世界を前進させる



ソリューションを開発しています。投資家その他の皆様は、KLAの株主・投資家情報(IR)ウェブサイト([ir.kla.com](http://ir.kla.com))を通して、証券取引委員会(SEC)への提出書類、プレスリリース、決算公告、カンファレンスウェブキャストなどの重要な財務情報を発表することに注意してください。追加情報については、[www.kla.com](http://www.kla.com)をご覧ください。

### 将来に関する記述

IC サブストレート向け新製品の性能に関する記述など、本プレスリリースに記載されている歴史的事実以外の記述は、将来の見通しに関する記述であり、1995年私的証券訴訟改革法によって創設されたセーフハーバー規定の対象となります。これらの将来に関する記述は、現在の情報と期待値に基づいており、リスクと不確実性を伴います。新技術の採用の遅れ（コストによるか、性能によるか、その他原因は問いません）、他社による競合製品の導入、またはKLA製品の導入、性能、使用に影響を及ぼす予期せぬ技術的課題もしくは制限、その他KLAの2024年6月30日終了年度の年次報告書(Form 10-K)およびKLAが証券取引委員会に提出したその他の提出書類に記載されたリスク・ファクター（同書に記載されているリスク・ファクターを含み、これに限定されません）など、さまざまな要因により、実際の結果は、予測された結果と大きく異なる場合があります。KLAは、これらの将来に関する記述を更新する義務を負わず、現時点でその意思もありません。

株主・投資家情報(IR)：株主・投資家情報担当 Vice President、Kevin Kessel、  
[kevin.kessel@kla.com](mailto:kevin.kessel@kla.com)

メディア関係：コーポレートコミュニケーション、Mike Dulin、[michael.dulin@kla.com](mailto:michael.dulin@kla.com)

+++++